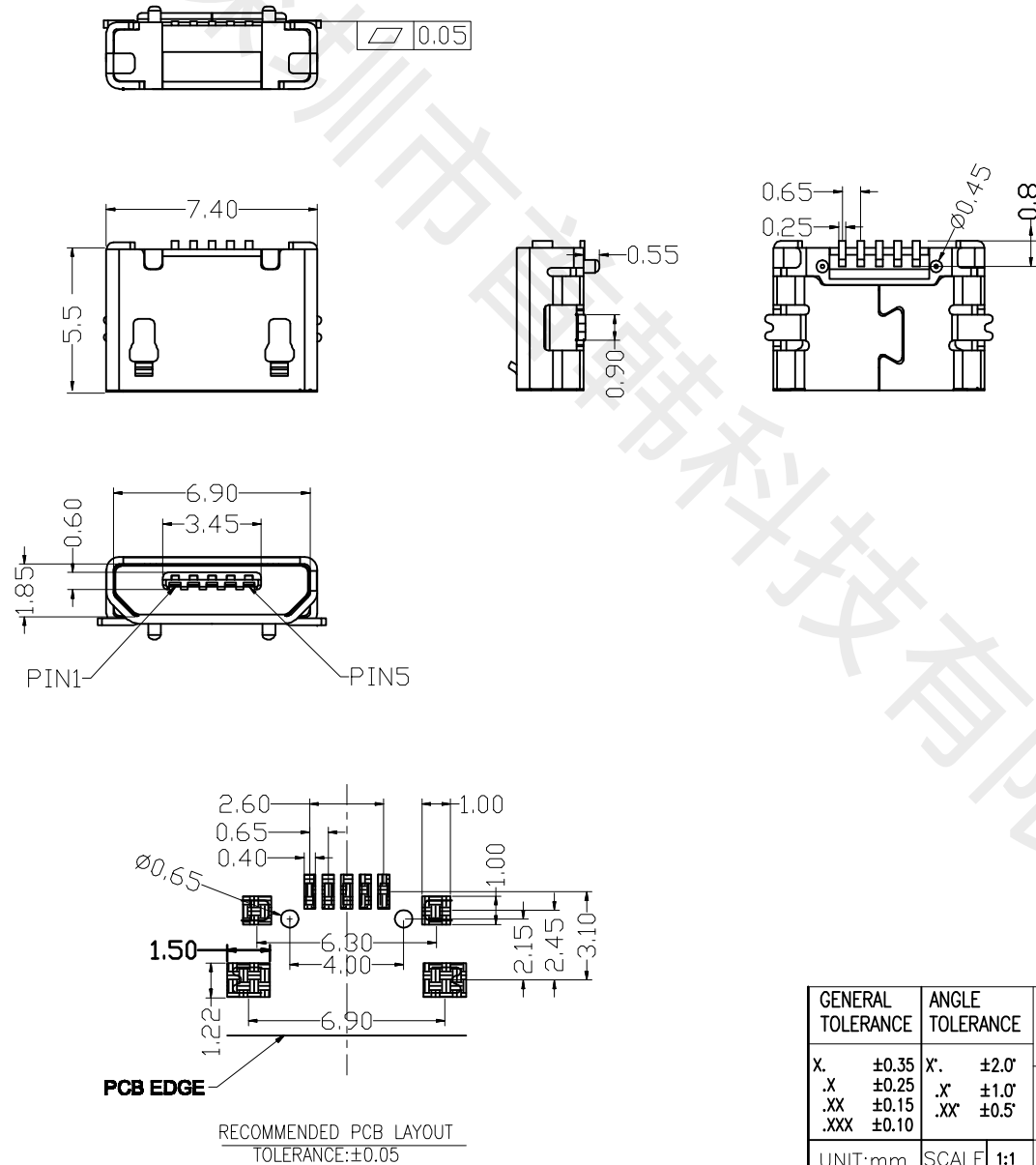



REV.	DESCRIPTION	DRAWN/DATE	APPROVED/DATE



#### NOTES:

1. MATERIAL:
  - 1.1 HOUSING:THERMOPLASTIC FLAMMABILITY RATING UL94-0
  - 1.2 CONTACT:COPPERY ALLOY T=0.15MM
  - 1.3 SHELL: COPPERY ALLOY T=0.25MM
2. FINISH:
  - 2.1 CONTACT:
    - 3U"MIN,PLATED ON CONTACT AREA
    - G/F PLATING ON SOLDER TAIL AREA
    - 50~80U" NICKEL UNDERPLATING OVERALL
  - 2.2 SHELL:
    - 80~120U" MATTER TIN PLAING ALL
    - 50~80U" NICKEL UNDERPLATING OVERALL
3. SPECIFICATION:
  - 3.1 CURRENT RATING: 1.0A
  - 3.2 VOLTAGE:30 VAC
  - 3.3 TEMPERATURE RANGE:-30°C~80°C
  - 3.4 CONTACT RESISTANCE:30 MILLIONHM MAX.
  - 3.5 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE;250VAC R.M.S
  - 3.6 INSULATION RESISTNACE:100 MEGOHMS MIN

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		DESIGN	DATE	 深圳市首韩科技有限公司	
X.	±0.35	X'.	±2.0'	李春风	2020. 12. 23		
.X	±0.25	.X'	±1.0'	CHECK	DATE	FILE NAME<??>	MICRO QTZB5.5
.XX	±0.15	.XX'	±0.5'	钟华华	2020. 12. 23	PART NO<??>	
.XXX	±0.10			APPRO.	DATE	DRAWING NO<??>	
UNIT:mm	SCALE	1:1		罗孝金	2020. 12. 23		REV. A0
A4							



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码  
material code:

产品名称 Project:

Micro座

规格型号 Part No:

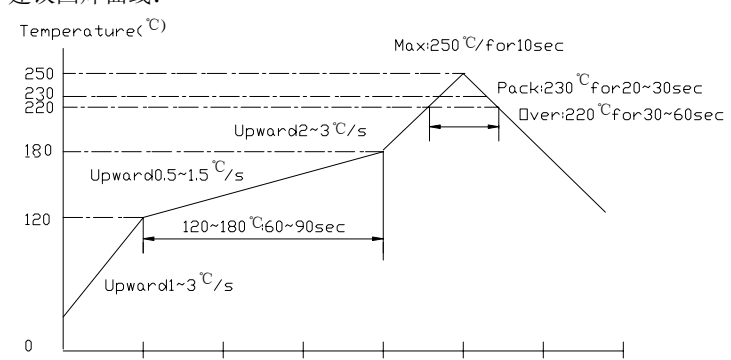
Micro QTZB5.5

#### 贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	张栋	
批准/Approved	罗孝金	

1. 物料明细:			
1.1. 塑胶部分: LCP UL94V-0			
1.2. 接触端子部分: C5191R-H, 镍底, 接触部位镀金 1μ"			
1.3. 外壳部分: C2680R-H, 外壳镀镍底 50μ", 镀镍 80μ"			
2. 工作条件:			
2.1. 工作电流: 1.0Ampere			
2.2. 使用温度: -30℃~+80℃			
3. 电气性能部分			
序号	测试项目	规格和标准	测试方法及参考标准
			以低功率电流测试产品接触部位阻抗值
3.1	接触阻抗	30mΩ MAX	参考: EIA 364-23A
3.2	绝缘阻抗	100MΩ MIN 100V DC	测试相邻接触脚位之间塑胶阻抗值 参考: EIA 364-21A
3.3	耐压测试	250V AC 1 分钟 0.5mA	以 0.5mA 的电流测试接触脚位之间塑胶耐高压 1 分钟 参考: EIA 364-20A
4. 机械性能部分			
4.1	插入力	3.57kgf	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度插入时的力 参考: EIA 364-13A
4.2	拔出力	1.00kgf	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度拔出时的力 参考: EIA 364-13A
4.3	端子单 PIN 保持力	0.3 kgf MIN	接触 PIN 以 25mm/分速度从塑胶中退出来的力
4.4	寿命测试	1. 产品外观无明显损伤 2. 插入力: 3.57kgf MAX 出力: 0.81~2.05 kgf	以每小时 600 次匀速插拔产品 3000 次 参考: EIA 364-09A
4.5	振动测试	10 <sup>-6</sup> 秒	以每分钟频率由 10HZ 至 55HZ, 再回到 10HZ 为一循环, 连续测试 X/Y/Z 三个方向各 2 小时。 振幅为 1.5mm 参考: EIA 364-28A
5. 环境性能部分			
5.1	沾锡性	吃锡面积达 95%以上	产品焊接区于温度为 235±5℃锡炉中浸泡 5±0.5 秒 参考: MIL STD-202F
5.2	耐高温	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗30mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于 85℃的高温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.3	低温性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 30mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于-40℃的低温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.4	耐湿性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 30mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于温度为 40±2℃, 湿度为 90~95RH 环境中, 120 小时后观察。 参考: EIA 364-31A
5.5	耐腐蚀性	1. 外观无明显腐蚀 2. 接触阻抗 30mΩ MAX	将产品置放于盐水浓度为 5%, 温度 35±2℃的盐雾箱中连续喷雾 24 小时, 于常温放置 1 小时后观察产品。 参考: EIA 364-26A
5.6	耐焊接性	1. 外观无明显变色、起泡; 2. 焊脚吃锡平滑	建议回焊曲线:  <p>The graph shows a temperature profile for reflow soldering. The y-axis is Temperature (°C) from 0 to 250. The x-axis is time (sec) from 0 to 180. The profile starts at 0°C, rises at 1~3°C/s to 120°C, holds at 120~180°C for 60~90sec, then rises at 0.5~1.5°C/s to 180°C, then at 2~3°C/s to a peak of 230°C (labeled Pack 230°C for 20~30sec), holds at 230°C for 20~30sec, then falls at 2~3°C/s to 220°C (labeled Over 220°C for 30~60sec), and finally falls at 1~3°C/s to 180°C. A note indicates Max: 250°C for 10sec.</p>